

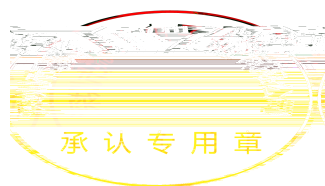
SPECIFICATION 产品 书

产品型号

R&D 发

产供

REFOND



目录

产品
产品
产品 征.....
产品应
封 尺寸.....
产品参

典型光学

产品包
包
带尺寸.....



1.1 General Description 产品

产品为 光 ， 光 封 形 ， 产品尺寸： 。

1.2 Features 产品 征

发光 度大

于 SMT 和 工

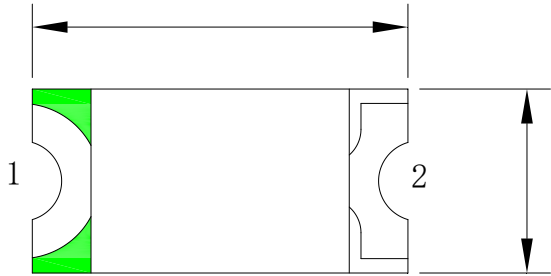
Level3

RoHS

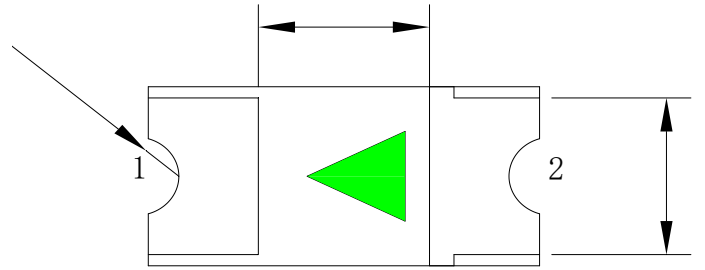
1.3 Application

REFOND

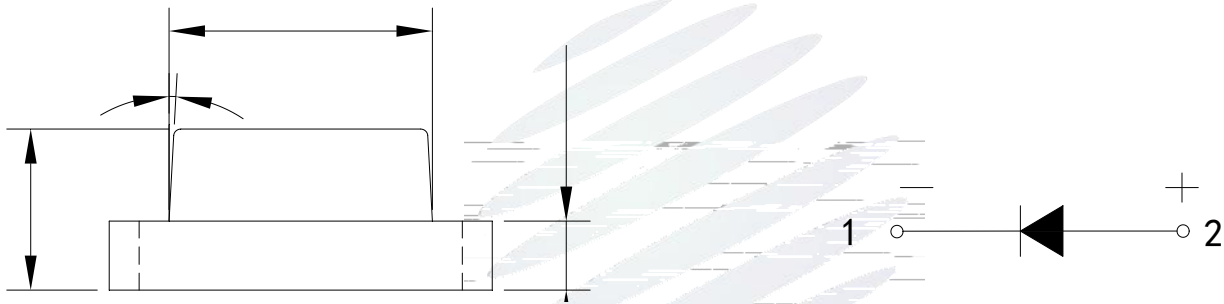
1.4 Package Dimension 封 尺寸



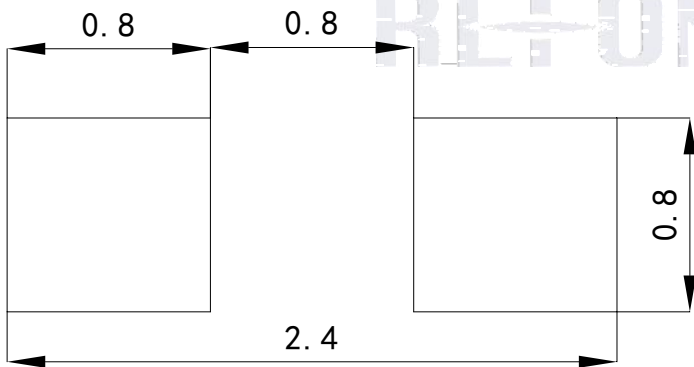
图



图



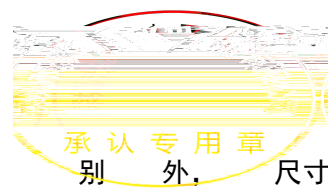
侧 图



备 ：

1. 尺寸 单位为

±

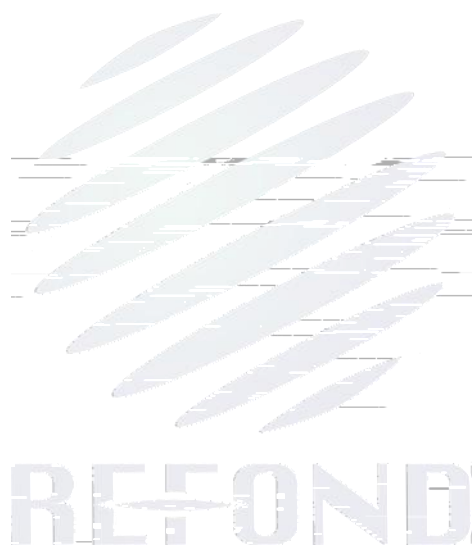


尺寸公差为±0.2

1.5 Product Parameters 产品参

与光学

件 号



备 为 分 件。

对 大值

(参)	(号)	(值)	(单位)
(功)			
(向)			
(冲峰值)			
()			
(作 度)			
(储存 度)			
()			

备 :

宽0.1ms, 占 1/10.

以上 压 差 ±0.1V.

以主 差±2nm.

上 发光强度 允 公差为±10%.

使

功 不 定 大值。

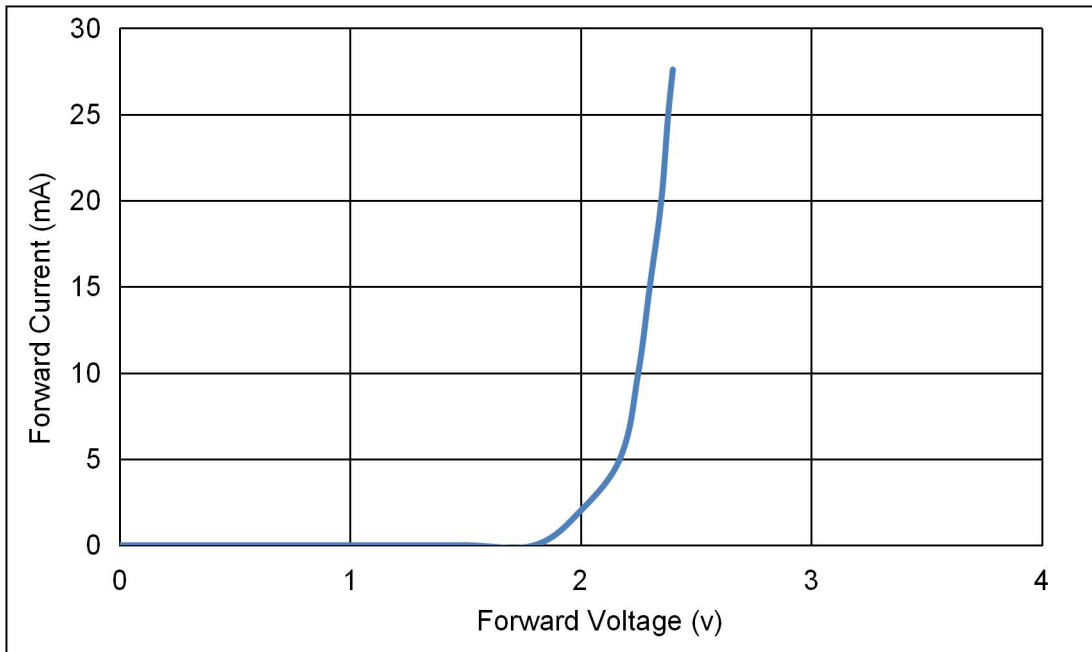
基于 丰

准 平台。

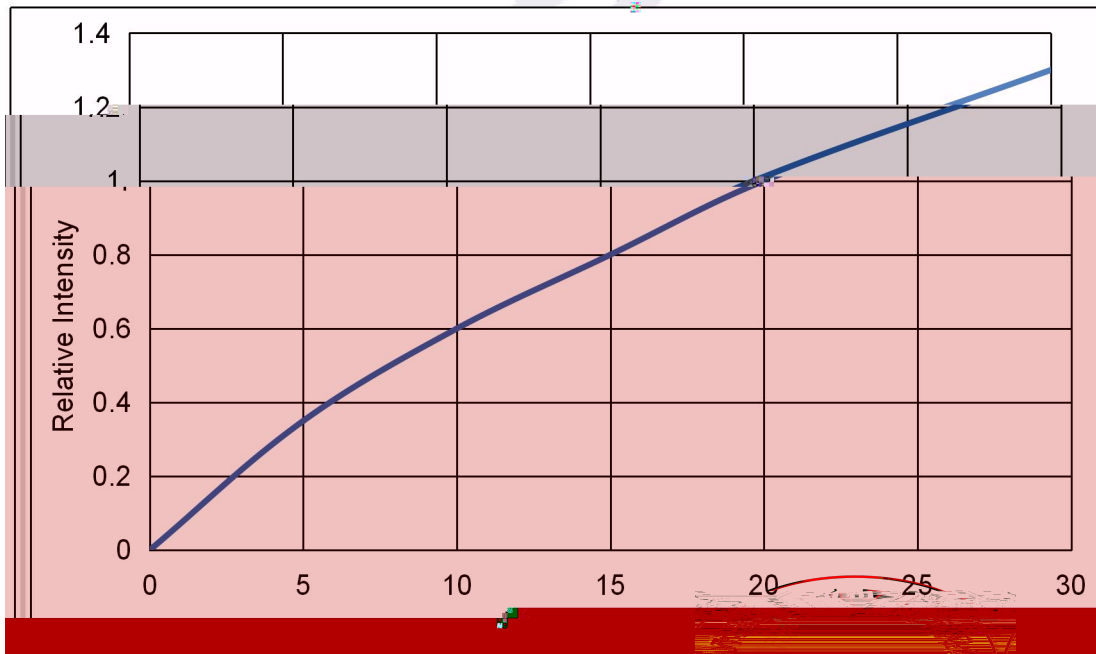
件 定, 不 大值。



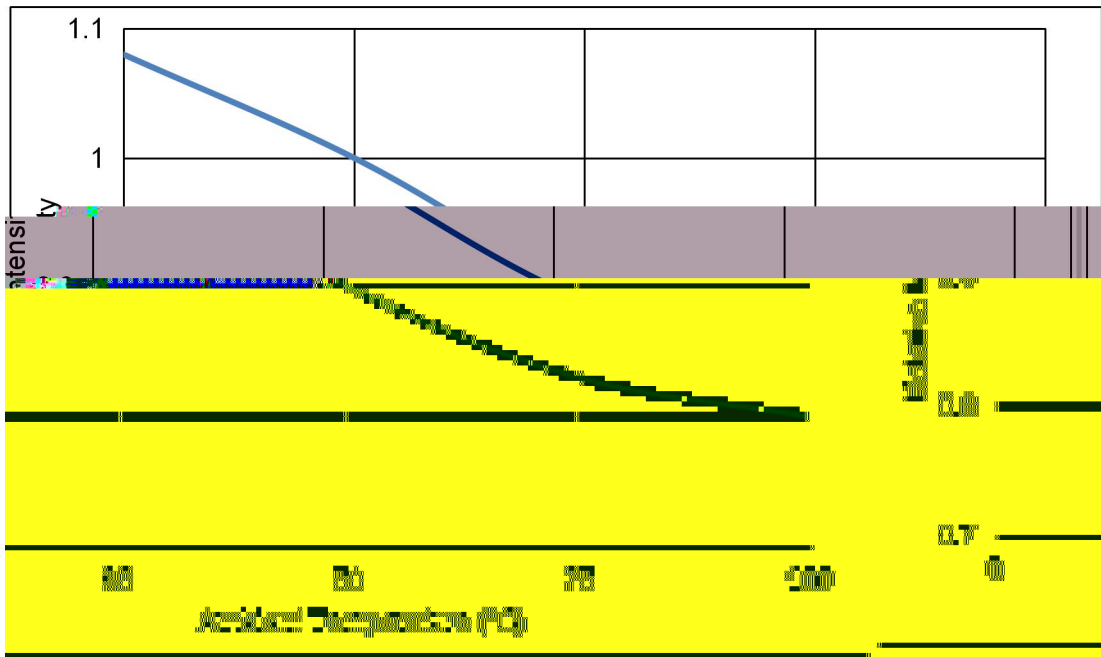
1.6 Typical Optical Characteristics Curves 典型光学



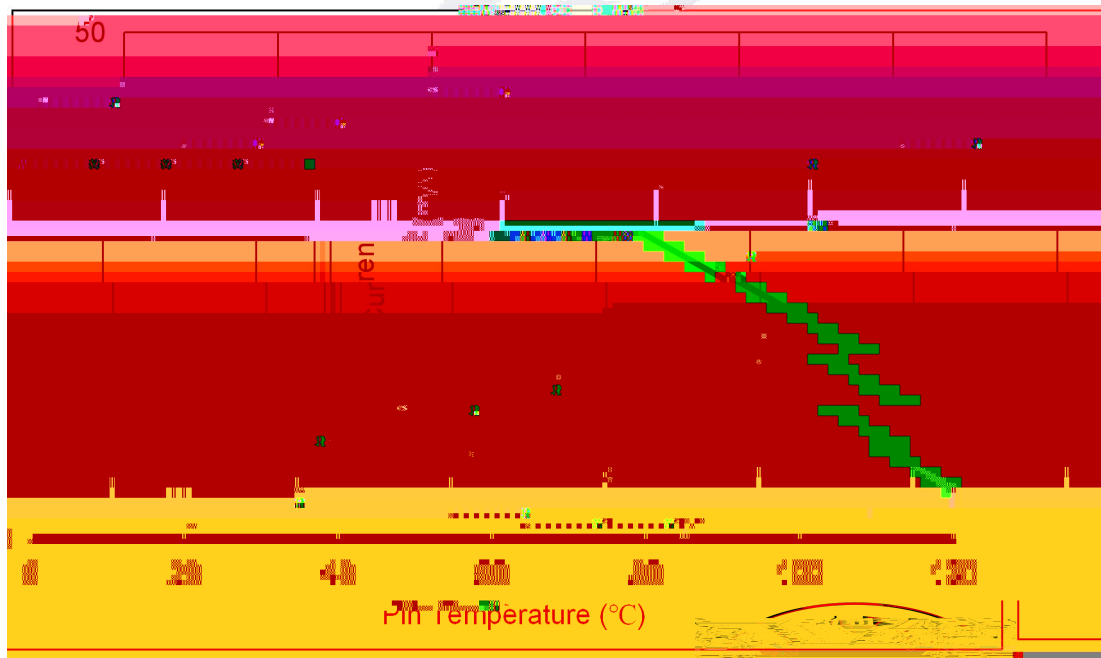
伏安



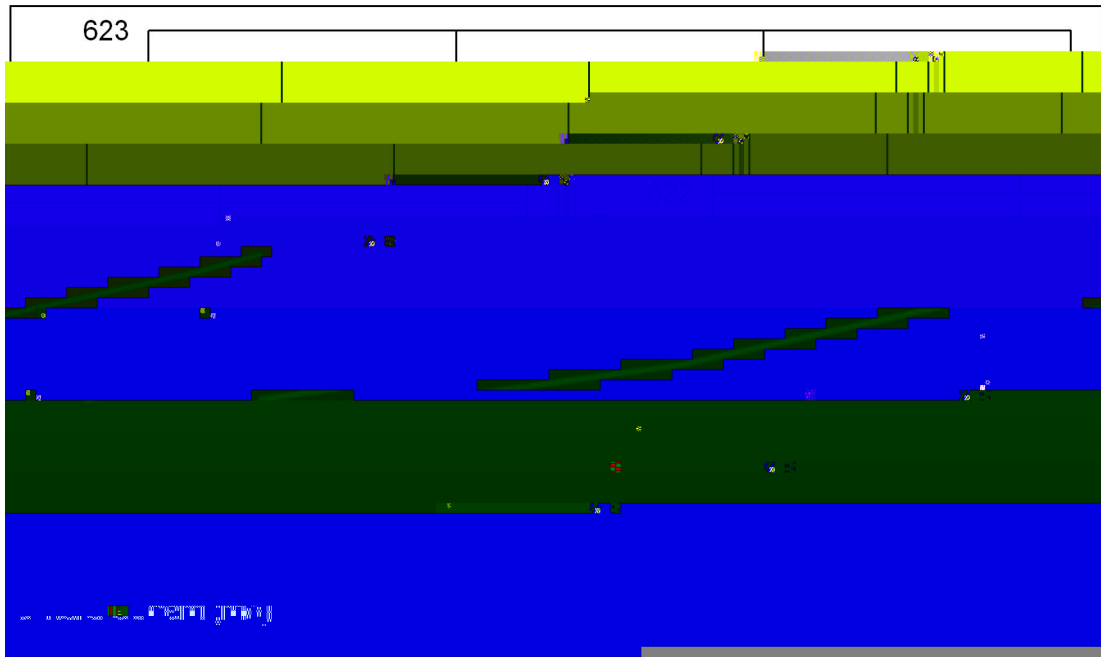
承认专用章
向与对光强



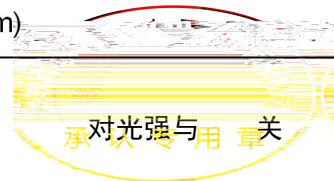
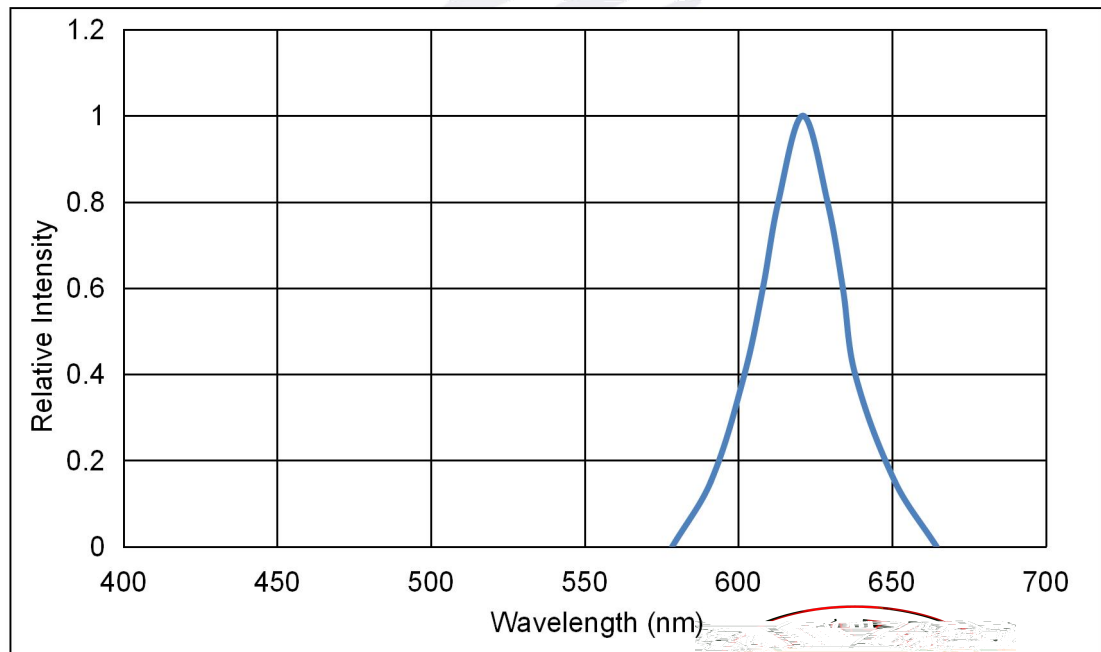
引 度与 对光强



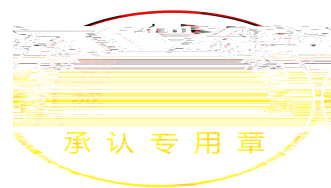
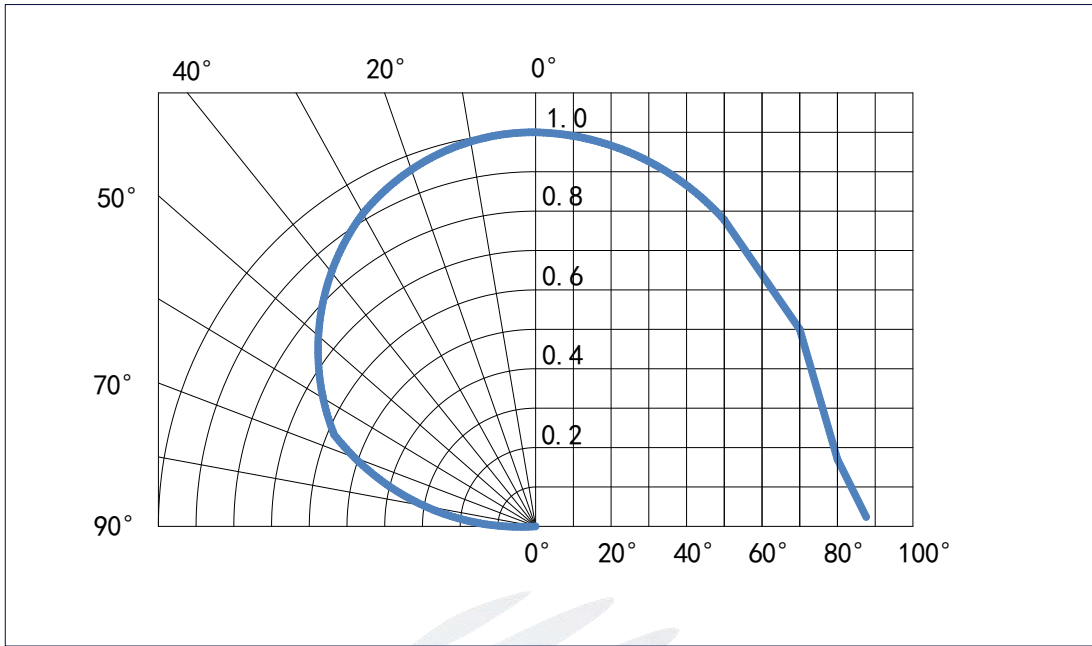
引 度与 包用章



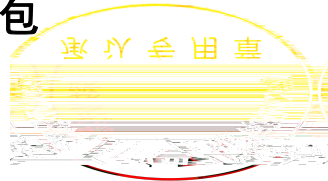
向 与 主 关



对光强与 关



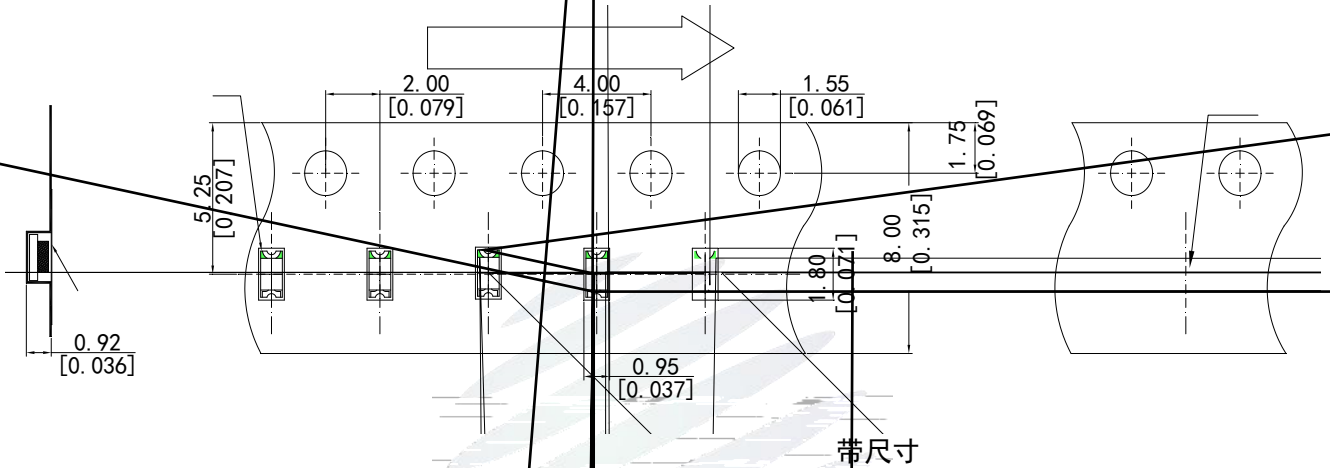
2. Packaging 产品包



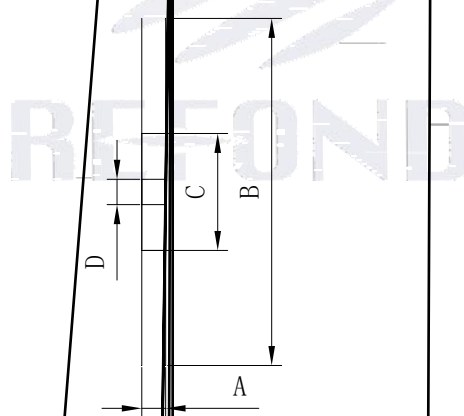
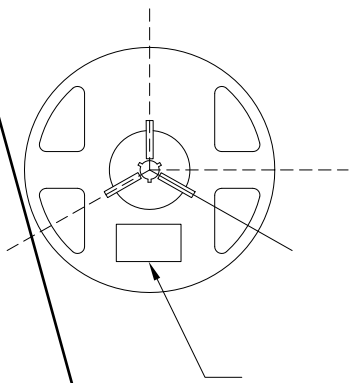
2.1 Packaging Specification 包

包 卷

带 尺寸



卷 尺寸





尺寸

	±
	±
	±
	±

卷 尺寸

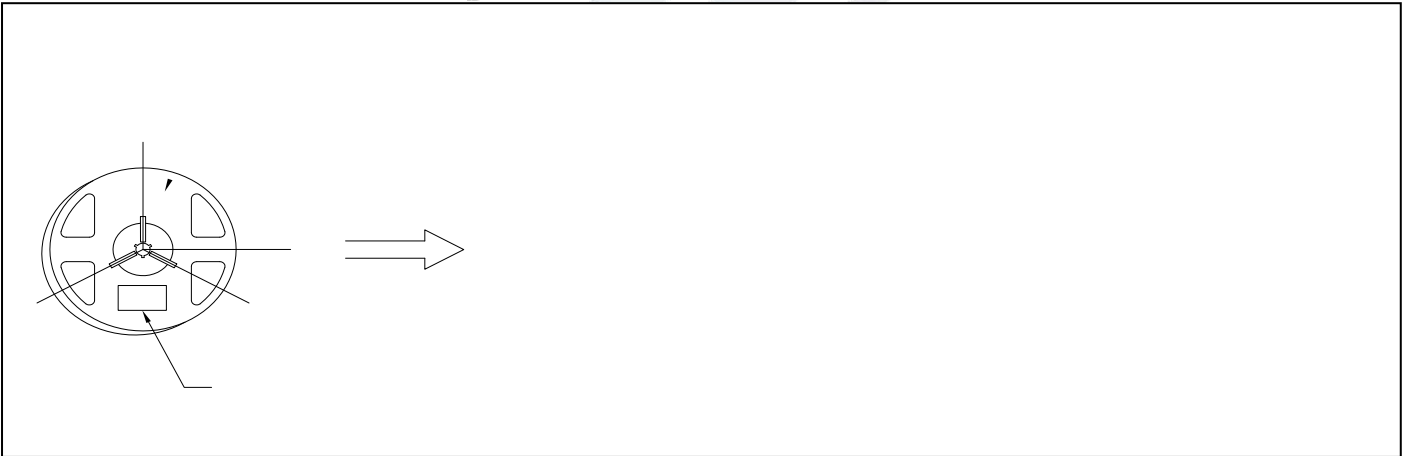
备 注 :

公差为 ±0.1 ， 尺寸单位： 。

PART NO:		
SPEC NO:		
LOT NO		
BIN CODE:		
Φ:	XY:	
VF:	WLD:	
		
		QTY:
		DATE:

参
品名
号
参代
光
区
向压
代
产

2.2 Moisture Resistant Packing 包



包

2.3 Cardboard Box 包

2.4 Reliability Test Items And Conditions 信

及 件



及 件

回

2.5 Criteria For Judging Damage 失 判定 准

失 判定 准

	号	件	判定 准	
				大
向 压				
光				

备 ：

上 REFOND 下

以上可 基于 丰 实 平台单 / LED在 好 件
下 。客 将LED应 于串、并 ， 估 、 压分 、 。

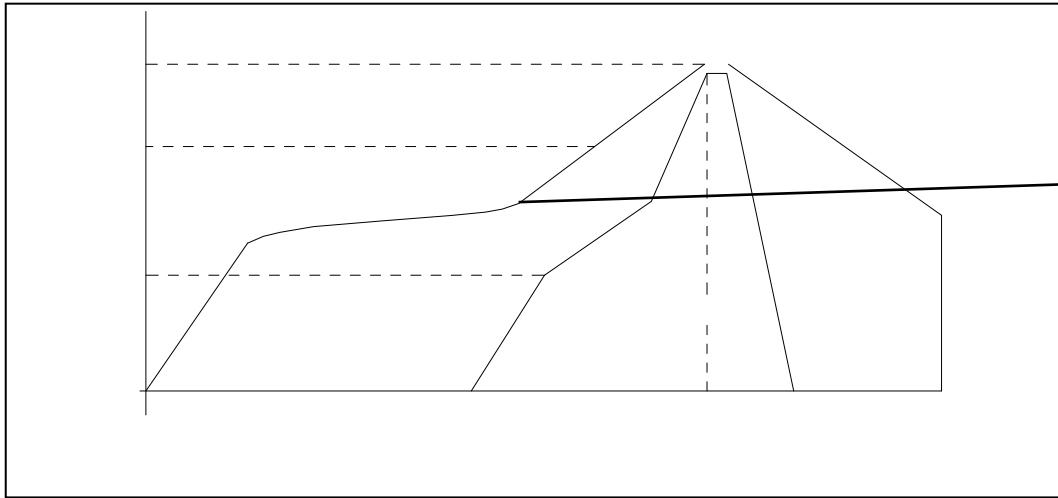
以上 仅为产品 典型值，只作为参 ，不作为任何应 件及应 式 保 。



3. SMT Reflow Soldering Instructions SMT



3.1 SMT Reflow Soldering Instructions SMT 回



回
参

平均升 度 ()	
: 低 度	
: 度	
: ()	
: 度	
:	多
峰值 分 度	
峰值分 度: ()	多
。 与实 峰值 度	多
差 以内 保 度	
升 峰值 度	多 分

备：

坏。

回 不可以 两，两回



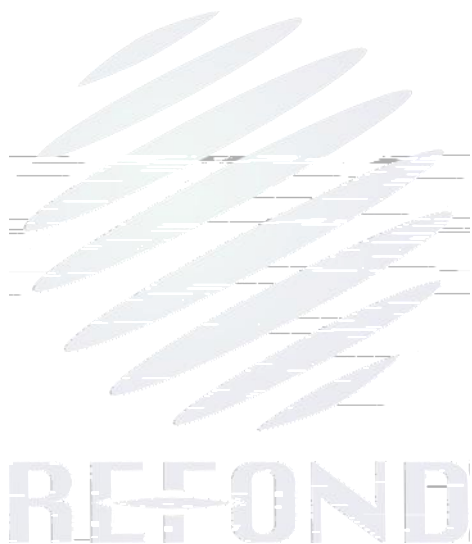
如 24小，LED可 于吸

当，不在 受 力压 体。

.当 工， 度必 小于300°C， 不可 3。

工 只可 一。

修



4. Handling Precautions 产品使 事

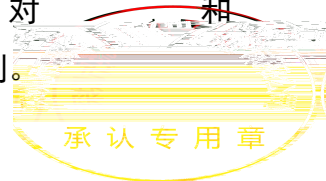
4.1 Handling Precautions 产品使 事

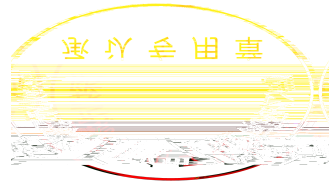
工作 境及与 LED 中 元 及化合 份不可 100PPM. 只
一个建 , 不作任何品 保。

为了 外 入LED内 以 LED 伤, 处
境及 套件 , 单一 元 含 小于 900PPM, 单一 元 含 小于 900PPM, 元
与 元 含 必 小于 1500PPM. 只 一个建 , 不作任何品 保。

REFOND

应 套件中 发 会 到LED内 , 在 产 光
子及 件下, 会导 LED变 , 严 光 , 前了 套件 够 免产 些 。
丰反对使 任何对 LED 器件 可 害 , 不 些 已 实了
仅仅怀 害。对 定 和使 境, 丰建 对 和 容 。
在 LED 候, 不 使 产 发 体 剂。





LED
 不 定 大值, 同 , 使 保 , 否则, 微小 压变化将会引 大
 变化, 可 导 产品 。 必 保 只 在开启 关 候出 向 压 变化, 不
 加反压, 否则会 坏 LED。

容 因为 发 和 境
 度 变 变, 度升 会 低 LED 发光 , 影响发光 , 以在 应充分
 。

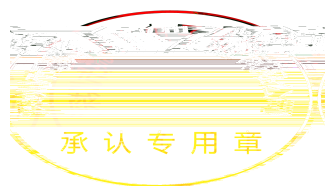
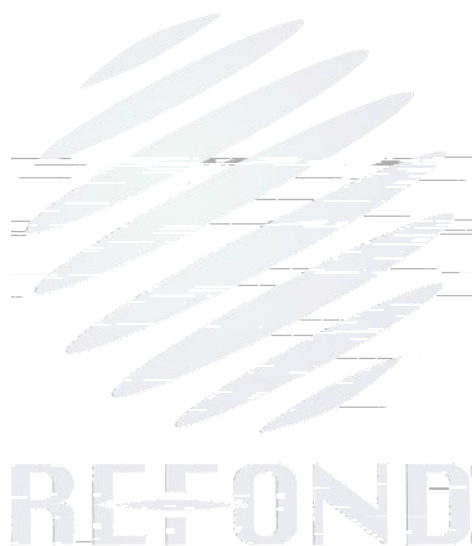
储存

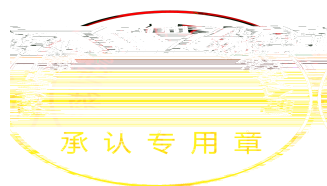
		度	度	
储存	包前	\leq °C	\leq	一年内
	包后	\leq °C	\leq	小
		\pm °C		\geq 大于 小

如 干 剂 包 失 , 产品不 合以上
 储存 件, 包后 , 件: $60 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 大于 24 小 。

如 包

像其他 半导体 子器件一 ， LED 对 击 常 ，
做好 。
关 。 其它 事 参 丰





产品 书以中 式书写, 冲 以中 为准。